

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第57號

民國111年6月22日辯論終結

原告 鴻勁精密股份有限公司

代表人 謝昺達

訴訟代理人 蘇士傑專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 許人偉

參加人 胡自強

訴訟代理人 黃政誠專利師

丁國隆專利代理人

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國110年9月9日經訴字第11006307450號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

原告起訴時訴之聲明原為：「一、原處分於及訴願決定均撤銷。二、被告應就第106109963N01號『堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備』發明專利請求項1至10應為『舉發成立應予撤銷』之審定」（本院卷第13至15頁）；嗣於民國110年12月3日起訴狀（補正）將訴之聲明更正為「一、原處分於『請求項1至10舉發成立，應予撤銷』部分及訴願決定均撤銷。二、被告應就第106109963N01號『堆疊式封裝電子元件之壓測機構及其應用之測試分類設備』發明專利舉發案作成『請求項1至10舉發不成立』之處分，或另為適法之處分」（本院卷第351至352頁），其中就訴之聲明第一項更正部分僅使聲明更為明確，非屬訴之變更或追加，

01 合先敘明。另訴之聲明第二項部分，因專利權人之專利如遭
02 舉發，經專利專責機關為撤銷專利權之審定，專利權人就該
03 不利益之負擔處分，於行政訴訟中應提起撤銷訴訟救濟，蓋
04 其起訴如獲勝訴判決，經法院撤銷訴願決定及原處分，則原
05 已經專利專責機關撤銷之專利權，自然回復為未經撤銷前之
06 狀態（最高行政法院109年度上字第416號判決意旨參照），
07 而原告為專利權人，因其專利遭舉發經被告為撤銷專利之審
08 定，則揆諸前揭說明，本件應提起撤銷訴訟救濟即為已足，
09 原告亦於本院準備程序時撤回其訴之聲明第二項（本院卷第
10 458頁），自無不合，應予准許。

11 貳、實體方面

12 一、事實概要

13 原告前於106年3月24日以「堆疊式封裝電子元件之壓測機構
14 及其應用之測試分類設備」向被告申請發明專利，申請專利
15 範圍共10項，經被告於106年10月20日核准公告第I607223號
16 發明專利(下稱系爭專利)。嗣參加人於107年5月14日以系爭
17 專利有違核准時專利法第22條第2項及第26條第1項、第2
18 項、第4項及同法施行細則第18條第2項之規定，對之提起舉
19 發，原告則於108年6月14日提出系爭專利申請專利範圍更正
20 本（更正請求項1、7、8部分文字）。案經被告審查，認前
21 揭更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利違反前揭
22 專利法第22條第2項規定，以108年12月27日（108）智專三
23 （二）04228字第10821236220號專利舉發審定書為「108年6
24 月14日之更正事項，准予更正」、「請求項1至10舉發成
25 立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告對前揭舉發成
26 立部分之處分不服，經經濟部審議並依訴願法第28條第2項
27 規定，通知參加人參加訴願程序表示意見後，以109年8月27
28 日經訴字第10906308860號訴願決定書為「原處分關於『請
29 求項1至10舉發成立，應予撤銷』部分撤銷，由原處分機關
30 於6個月內另為適法之處分」之決定。參加人對於該訴願決
31 定不服，提起行政訴訟，經本院於110年6月9日以109年度行

專訴字第46號行政判決(下稱前案判決)撤銷前揭訴願決定，並於110年7月20日確定在案。經濟部爰依該確定判決意旨重為訴願審議，並以110年9月9日經訴字第11006307450號決定訴願駁回(下稱訴願決定)，原告不服，遂向本院提起本件訴訟。本院因認本件判決結果，倘認應撤銷原處分舉發成立部分及訴願決定，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張及聲明

(一)主張要旨：

- 1.如系爭專利說明書第【0010】段第13至25行之記載，第一、第二溫控器是藉導溫方式使對象物保持預設測試溫度，均可為致冷晶片或加熱件或具預溫流體之本體，故是否採用「傳導」方式來使對象物保持預設測試溫度非系爭專利請求項1與證據2的差異之處，關鍵在於證據2具調控溫度能力者僅「熱裝置柱塞」一個，而系爭專利請求項1之第一、第二溫控器各具調控溫度之能力，可依操作需求調整其功率，第二溫控器自身在採用不同器件之情形下，可藉由調控功率的高低來改變溫度。系爭專利說明書記載之實施例固有將第一、第二溫控器配合冷卻器一同使用，但冷卻器並非記載於申請專利範圍，第一、第二溫控器亦非必須配合冷卻器才能使用；況無冷卻器的溫控器是系爭專利所屬技術領域由來已久之通常知識，例如證據2的熱裝置柱塞即屬一例。因此，系爭專利請求項1之第二溫控器不應以配合冷卻器及第一溫控器同時使用為限，前案判決及訴願決定以系爭專利說明書記載之冷卻器判斷第二溫控器不具備獨立加熱或致冷之溫度控制能力之解釋，已不當將說明書內容讀入申請專利範圍。
- 2.又前案判決及訴願決定認為證據2之「熱裝置柱塞」、「熱中介片」均具有傳導溫度，可使頂端IC、邏輯裝置保持預設溫度之效果，惟證據2之熱裝置柱塞是發熱元件，而熱中介片自身不具調控溫度的能力，單以熱中介片無法改變溫度，自無法對應於系爭專利請求項1之第二溫控器，且證據2及其

01 他證據均未揭露系爭專利請求項1之「第一溫控器，以使該
02 第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該
03 第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電
04 子元件保持預設測試溫度」之技術特徵，故系爭專利請求項
05 1應具進步性。

06 3.系爭專利請求項2至4、6至10具有系爭專利請求項1之全部技
07 術特徵，因證據1、2之組合既不足以證明系爭專利請求項1
08 不具進步性，則亦不足以證明其他請求項不具進步性。又證
09 據4、5之技術領域與證據1、2之差距較大，證據1、2所屬技
10 術領域中具有通常知識者無可能思及結合證據4、5，且證據
11 5手段及目的、功能或作用與證據1、2均完全不同，亦無法
12 輕易完成系爭專利請求項1，則證據1、2、4之組合或證據
13 1、2、5之組合不足以證明系爭專利請求項2至4、6至10不具
14 進步性。另系爭專利請求項5間接依附於系爭專利請求項1，
15 則證據3因未揭露系爭專利請求項1「溫控單元」之技術特
16 徵，則證據1、2、3或證據1、2、3、4或證據1、2、3、5之
17 組合亦不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

18 (二)聲明：原處分關於「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」部
19 分及訴願決定均撤銷。

20 三、被告答辯要旨及聲明

21 (一)答辯要旨

22 1.系爭專利請求項1對於第一、第二溫控器並未有進一步之界
23 定，未明確限制「溫控器」屬於何種類之溫度控制器，依原
24 告所解釋之申請專利範圍，乃將系爭專利說明書之實施方式
25 讀入而不當限縮系爭專利請求項1之「第一、第二溫控器」
26 所界定之範圍，自非可採。縱依原告主張，系爭專利請求項
27 1之「第一、第二溫控器」限縮為致冷晶片或加熱件或具預
28 溫流體之本體其中之一者，然除了致冷晶片，「加熱件」及
29 「具預溫流體之本體」並非在所屬技術領域中具有明確涵
30 義，而系爭專利說明書對於「加熱件」或「具預溫流體之本
31 體」僅是記載一特定名稱，並未揭露相關技術內容，更無限

01 制其組成結構、材料或作動方式，故對於「加熱件」或「具
02 預溫流體之本體」，自不應以「具有獨立調控溫度能力的溫
03 控器」作為限縮解釋，是以原告起訴理由不足為憑。

04 2.系爭專利請求項1對於第一、第二溫控器僅載明「使該第
05 一、第二電子元件保持預設測試溫度」，並未有進一步之界
06 定，且系爭專利說明書或圖式亦未定義或揭露第一、第二溫
07 控器如何具有主動或獨立調整控制溫度高低的能力，僅僅揭
08 示第一、第二溫控器均係藉由「傳導」溫度方式，使該第
09 一、第二電子元件保持預設測試溫度而已，故只要能使各自
10 對象物（第一、二電子元件）保持於預設測試溫度之溫控器
11 即屬之，此方符合系爭專利請求項用語之字義及其最合理寬
12 廣之解釋。又證據2之第【0031】段所揭示之熱裝置柱塞105
13 會控制頂端IC130與熱中介片115之溫度，該熱中介片115會
14 經由接觸將熱傳導至邏輯裝置135，即知證據2之熱裝置柱塞
15 105對應系爭專利請求項1之第一溫控器，可使頂端IC135(對
16 應第一電子元件)保持溫度，且證據2之熱中介片115對應系
17 爭專利請求項1之第二溫控器，可使邏輯裝置135(對應第二
18 電子元件)保持溫度，亦即，證據2已對應揭示系爭專利請
19 求項1之「溫控單元：係裝配於該承載器之該承載件，並於
20 該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持
21 預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方
22 設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測
23 試溫度」之技術特徵，故原處分並無違誤。

24 3.證據1、2之組合既足以證明系爭專利請求項1至4、6至10不
25 具進步性，則證據1、2、4或證據1、2、5之技術內容，亦為
26 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術之組合
27 所能輕易完成者，亦足以證明系爭專利請求項1至4、6至10
28 不具進步性；另證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求
29 項5不具進步性，則證據1、2、3、4或證據1、2、3、5之組
30 合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

31 (二)聲明：原告之訴駁回。

01 四、參加入陳述要旨及聲明

02 (一)陳述要旨

- 03 1.本件專利有效性之比對基礎應以系爭專利請求項1所載文義
04 內容為準，即「凡能使各自對象物(第一、二電子元件)保持
05 於預設測試溫度之溫控器即屬之」，並未有進一步界定「第
06 一、二溫控器為各具調控溫度能力之器件；而原告過度解讀
07 說明書實施例內容，並不當將之讀入請求項，已變更申請專
08 利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。
- 09 2.證據2所揭露之「熱中介片115」因得導溫而加熱對象物(邏
10 輯裝置135)，以使對象物保持預設測試溫度，故亦屬系爭專
11 利說明書段落中所稱之「加熱件」應無庸置疑；又證據2說
12 明書段落【0026】已明確教示「如圖2中所示，一示範性系
13 統100包含一熱裝置柱塞105，其被連結至一熱控制單元(TC
14 U)110」，該熱控制單元(the Control unit, TCU) 110不論
15 配置方式抑或其功能均等同於系爭專利之「冷卻器」，是以
16 證據2並非如原告所稱為無冷卻器之溫控器。又前案判決從
17 未提及「第二溫控器不具備獨立加熱或致冷之溫度控制能
18 力」之內容，原告顯有誤認；縱依原告主張不當讀入「具調
19 控溫度能力之特徵，仍無增進或變更系爭專利之發明功效，
20 其中包括短訊號傳輸距離」、「保持二電子元件預設測試溫
21 度」、「避免擴增機台之體積」及「自動化作業」等功效早
22 為舉發證據所得完全實現，系爭專利難謂具備無法預期之功
23 效，不具進步性至為明確。
- 24 3.證據1圖1揭示測試臂42可垂直向上下作動且下方部位也具備
25 有吸附待測物的功能，可證明系爭專利請求項2不具進步
26 性；證據2圖3所揭露之「熱基座220」及「熱中介片10」實
27 質等同於系爭專利請求項3之「導溫座」；證據2所揭露之
28 「熱裝置柱塞」係用於接觸並對頂端IC進行溫度調控，必然
29 具有系爭專利請求項4所請「接合部件」；證據1所揭露之
30 「探針測試裝置433」與「第一測試座」不論配置方式、作
31 動原理、或所產生之功效均完全相同，且證據2之「熱中介

片115」實際上也用於承置頂端IC130，且透過測試探針導線（實質等同於系爭專利之第一傳輸件）來電性連接頂端IC130和底部IC135，再加上，熱中介片115係位於熱裝置柱塞105（實質等同於系爭專利之導溫座）下方，可證明系爭專利請求項6不具進步性；證據1之「探針測試裝置433」實質上已揭露「對電子元件執行預設作業之作業治具」，特別是「探針測試裝置433」的下端面部，其同樣是透過探針來接觸待測晶片，並執行預設之檢測作業，且證據2之「熱中介片115」的下端部，同樣也是用來接觸底部IC，並執行預設之檢測作業，可證明系爭專利請求項7不具進步性；證據2說明書第【0019】段揭示「本發明為一種加工裝置轉接器，其會在熱測試期間同步接觸一頂端IC（通常為一記憶體）以及一底部IC（通常為邏輯裝置），並且在寬廣的溫度範圍中（舉例來說， -55°C 至 $+150^{\circ}\text{C}$ ）維持兩個IC的溫度」；且證據2圖3中揭露各熱流（205、210、235、240）的方向，可知該發明所屬技術領域中具通常知識者可依設計需求，將熱裝置柱塞、熱中介片簡單改變為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體，可證明系爭專利請求項8不具進步性；證據2所揭露之「熱控制單元(thermal control unit, TCU)110」此一構件，即具有加熱控制或冷卻控制之意，可證明請求項9內容「冷卻器」不具進步性；證據1所揭露之「用以提供擺放具有複數待測晶片61之載盤11的進料區1」實質等同於「供料裝置」、證據1所揭露之「用以提供擺放具有複數完測晶片62之複數載盤21的出料區2」實質等同於「收料裝置」、證據1所揭露之「測試區4」實質等同於「測試裝置」、證據1所揭露之「拾取臂3」實質等同於「輸送裝置」。再者，證據1說明書第8頁末段至第9頁第18行揭露自動化測試流程而隱含「中央控制裝置」，已揭露系爭專利請求項10。因此，證據1及2之組合可證明系爭專利請求項1至4、6至10不具進步性，則證據1、2、4或1、2、5之組合亦足以證明系爭專利請求項1至4、6至10不具進步性。

01 4.證據3說明書第【0023】段揭示「隔離板用來使歧管及通道
02 板彼此熱絕緣。通道板處於或接近半導體裝置之所要溫度。
03 …隔離板用來防止熱量在歧管之冷或熱流體與冷卻通道之間
04 的方向上之傳遞。此使得熱量傳遞主要是與通道板之通道中
05 的流體進行」，所屬技術領域中具有通常知識者，有動機參
06 酌證據3中所揭露之「隔離板」，且證據3之「隔離板」與
07 「隔離件」達成相同功效，是證據1、2及3之組合可證明系
08 爭專利請求項5不具進步性；則證據1、2、3、4及1、2、3、
09 5之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

10 (二)聲明：原告之訴駁回。

11 五、爭點(本院卷第546至547頁)

12 (一)證據1、2之組合是否足以證明系爭專利請求項1至4、6至10
13 不具進步性？

14 (二)證據1、2、4之組合及證據1、2、5之組合是否足以證明系爭
15 專利請求項1至4、6至10不具進步性？

16 (三)證據1、2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步
17 性？

18 (四)證據1、2、3、4之組合及證據1、2、3、5之組合是否足以證
19 明系爭專利請求項5不具進步性？

20 六、本院之判斷

21 (一)本件應適用之法規

22 按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定，
23 專利法第71條第3項前段定有明文。查系爭專利之申請日為1
24 06年3月24日，核准審定日為106年10月20日，故本件關於系
25 爭專利是否具有應撤銷事由之判斷，自應以審定時所適用之
26 106年1月18日修正公布、106年5月1日施行之專利法（下稱
27 核准時專利法）為斷。又按發明雖無第一項所列情事，但為
28 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕
29 易完成時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2
30 項亦有明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前
31 揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉

01 發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其
02 發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足
03 以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之
04 處分。

05 (二)系爭專利技術分析

06 1.系爭專利技術內容

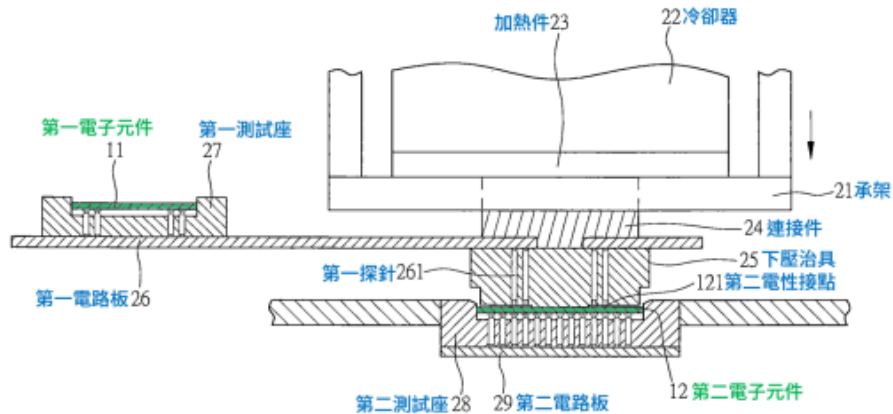
07 (1)習知的堆疊式封裝電子元件，係以具良品第一電子元件之測
08 試裝置對待測之第二電子元件進行測試，以淘汰出不良品第
09 二電子元件；該測試裝置之壓測機構係於一側裝配有第一測
10 試座(27)承置一為良品之第一電子元件(11)，使第一測試座
11 (27)連接承置第二電子元件(12)之第二測試座(28)，並透
12 過冷卻器(22)及加熱件(23)導溫第二電子元件(12)，使第二
13 電子元件(12)於預設溫度範圍內執行測試作業；惟於使用上
14 具有第一電子元件(11)與第二電子元件(12)之間具有較長的
15 訊號傳輸距離，以致易發生雜訊而影響測試品質，造成測試
16 品質不佳，以及第一電子元件(11)與第二電子元件(12)無法
17 於同一溫度下執行測試作業，造成影響測試品質等缺失(系
18 爭專利說明書第【0003】段及第3圖，即原處分卷(一)第96至9
19 8、84頁)。

20 (2)系爭專利乃提供一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構(30)，
21 其係於承載器之承載件(32)設有作業治具(321)，並於內部
22 設有導溫座(33)，測試單元係於導溫座(33)之下方設有具第
23 一傳輸件(351)之第一測試器，該第一測試器承置至少一接
24 觸導溫座(33)之第一電子元件(41)，並以第一傳輸件(351)
25 之一端電性連接第一電子元件(41)，而另一端則電性連接第
26 二電子元件(42)，溫控單元係於承載器之導溫座(33)設有第
27 一溫控器(36)，以導溫第一電子元件(42)保持預設測試溫
28 度，另於承載器之作業治具上方設有第二溫控器(38)，以導
29 溫第二電子元件(42)保持預設測試溫度；藉此，該壓測機構
30 (30)不僅縮短第一、二電子元件(41、42)之訊號傳輸距離而
31 避免雜訊，並利用溫控單元(36、38)控制第一、二電子元件

(41、42)保持預設測試溫度執行測試作業，達到提升測試品質之實用效益(原處分卷(一)第100頁)。

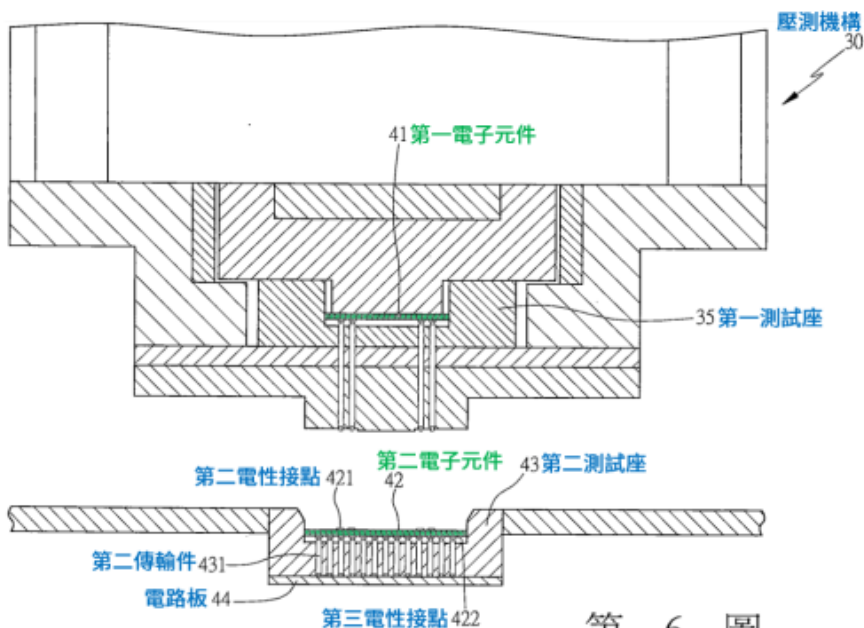
2.系爭專利主要圖式

(1)第3圖為習知壓測機構之使用示意圖(原處分卷(一)第84頁)



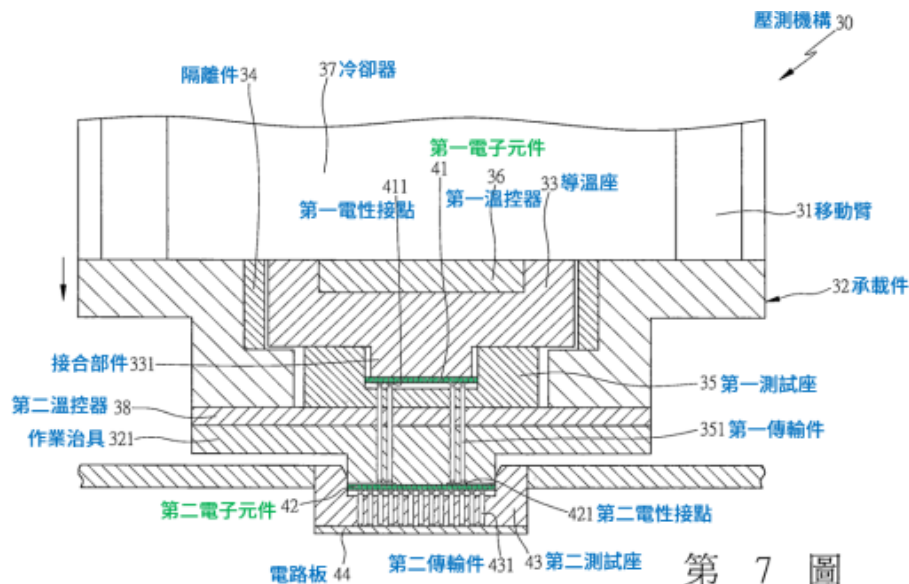
第 3 圖

(2)第6圖為壓測機構之使用示意圖(原處分卷(一)第81頁)



第 6 圖

(3)第7圖為壓測機構之使用示意圖(原處分卷(一)第80頁)



第 7 圖

3.申請專利範圍

系爭專利原核准公告之請求項共10項，其中第1、10項為獨立項，其餘為附屬項。專利權人(即本件之原告)於舉發階段提出108年6月14日更正本，更正請求項1、7、8，經被告審認應准予更正並公告在案。系爭專利請求項1至10（更正本）為兩造、參加人本件所爭執之請求項，其內容如下（原處分卷(三)第63頁）：

(1)請求項1：一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構，包含：

承載器：係設有至少一承載件；

測試單元：係裝配於該承載器之該承載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連接一第二電子元件；

溫控單元：係裝配於該承載器之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度。

(2)請求項2：依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該承載器係設有作至少一方向位移之移動臂，該移動臂係裝配該承載件。

(3)請求項3：依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該承載器係於該承載件上設有至少一導

溫座，該測試單元之該第一測試器係承置至少一接觸該導溫座之該第一電子元件，該溫控單元係於該導溫座裝配該第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度。

(4)請求項4：依申請專利範圍第3項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該承載器之該導溫座係設有至少一接合部件，該接合部件係接觸該第一電子元件。

(5)請求項5：依申請專利範圍第3項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該承載器係於該承載件與該導溫座之間設有至少一隔離件。

(6)請求項6：依申請專利範圍第3項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該測試單元之該第一測試器係設置於該承載器之該承載件上且位於該導溫座下方，該第一測試器係設有具第一傳輸件之第一測試座，該第一測試座之該第一傳輸件電性連接該第一電子元件之第一電性接點。

(7)請求項7：依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該承載器之該承載件係設有至少一對該第二電子元件執行預設作業之作業治具。

(8)請求項8：依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該溫控單元之該第一溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體，該第二溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體。

(9)請求項9：依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，其中，該溫控單元係於該承載件裝配有至少一冷卻器。

(10)請求項10：一種應用堆疊式封裝電子元件之壓測機構的測試分類設備，包含：機台；供料裝置：係裝配於該機台，並設有至少一容納待測之第二電子元件的供料承置器；收料裝置：係裝配於該機台，並設有至少一容納已測之該第二電子元件的收料承置器；測試裝置：係裝配於該機台，並設有至少一承置該第二電子元件之第二測試器，以及至少一依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，以

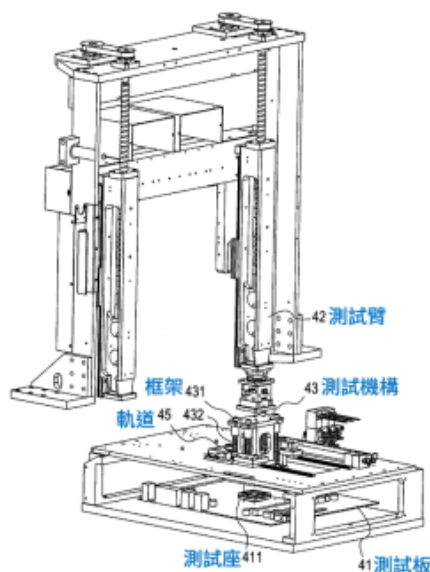
對該第二電子元件執行預設測試作業；輸送裝置：係裝配於該機台，並設有至少一移載該第二電子元件之移料器；中央控制裝置：係用以控制及整合各裝置作動，而執行自動化作業。

(三)本案之舉發證據

參加人於舉發階段提出證據1至證據5作為舉發證據，其中：

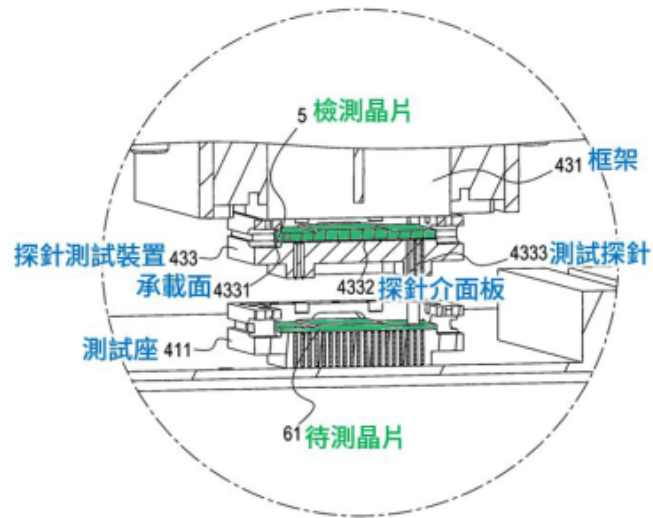
1.證據1為2013年11月16日公開之我國第201347062號「測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台」發明專利案(原處分卷(一)第49至78頁)，主要圖式如下(原處分卷(一)第60至62頁)：

(1)圖1係一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統結構圖



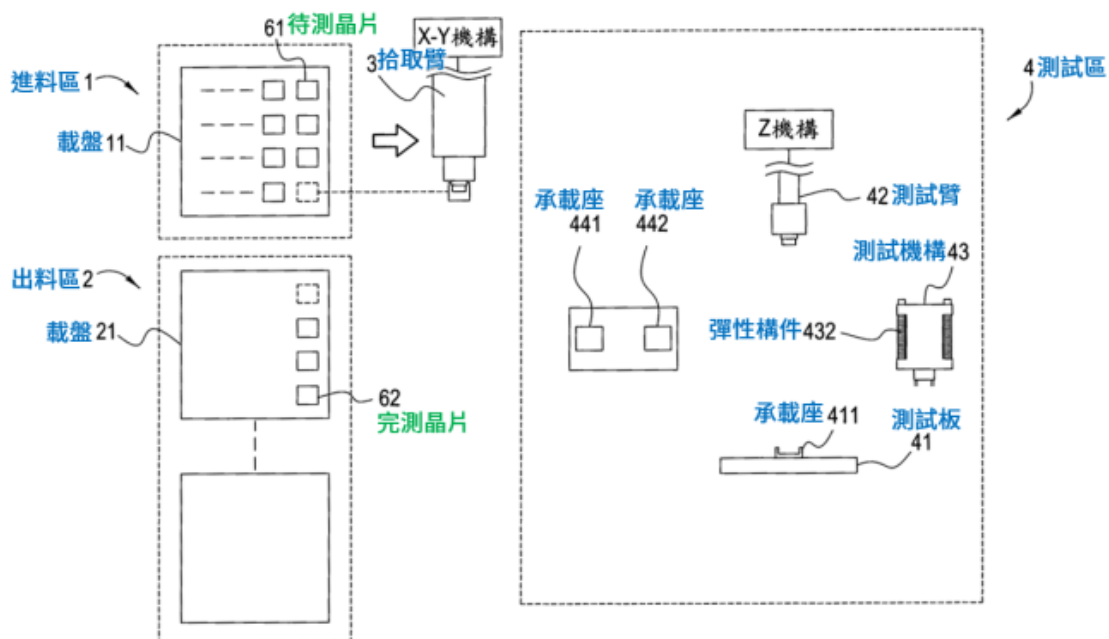
證據1 圖1係一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統結構圖

(2)圖2為一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統部份結構剖面圖

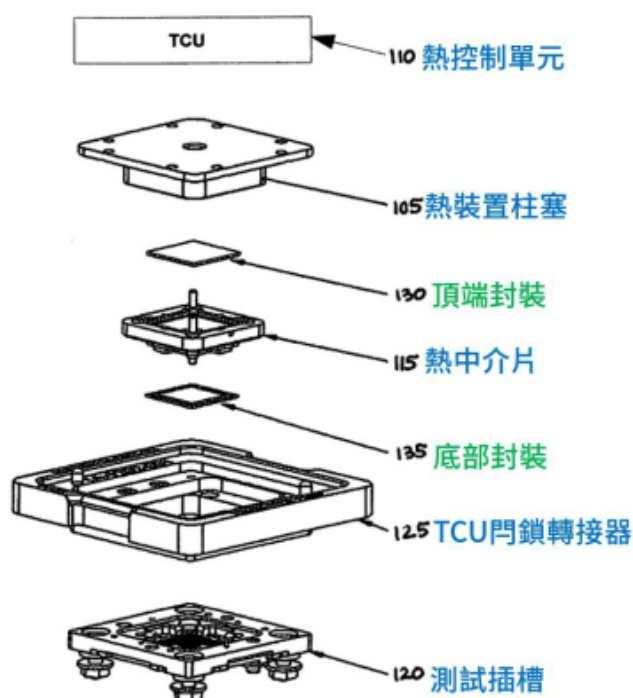


證據1 圖2為一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其半導體自動化測試機台之測試系統部份結構剖面圖

(3)圖3A為半導體封裝堆疊晶片之測試系統及其自動化測試機台之測試運作示意圖



2.證據2為2015年11月16日公開之我國第201543638號「堆疊式封裝熱力裝置」發明專利案(原處分卷(一)第33至48頁)，主要圖式如下：



證據2 圖2 係示範性熱中介片的系統方塊圖

3.證據3為2017年1月1日公開之我國第201701384號「用於半導體裝置測試之在溫度控制致動器中增進流體流動的技術」發明專利案(原處分卷(一)第1至32頁)，其主要圖式如下：
圖1係半導體裝置溫度控制致動器之一部分的側面截面視圖

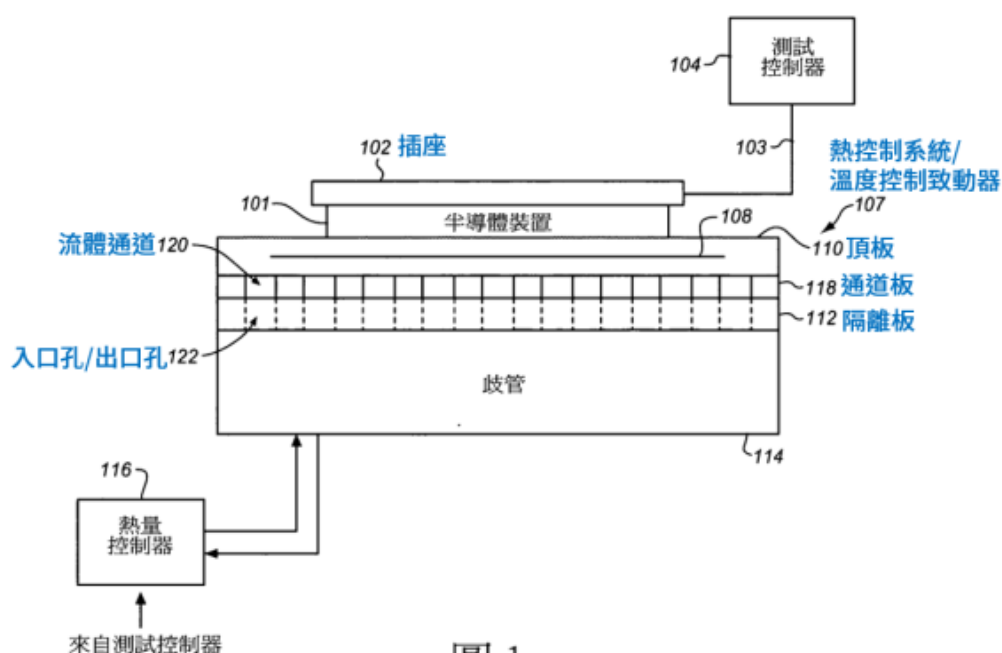
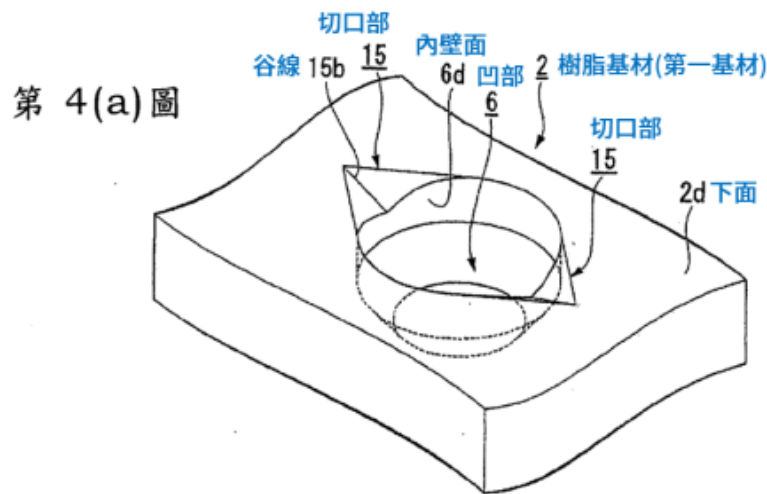


圖 1

4.證據4為2009年9月16日公開之我國第200938841號「反應晶片及反應方法、基因處理裝置用溫度調節機構及基因處理裝

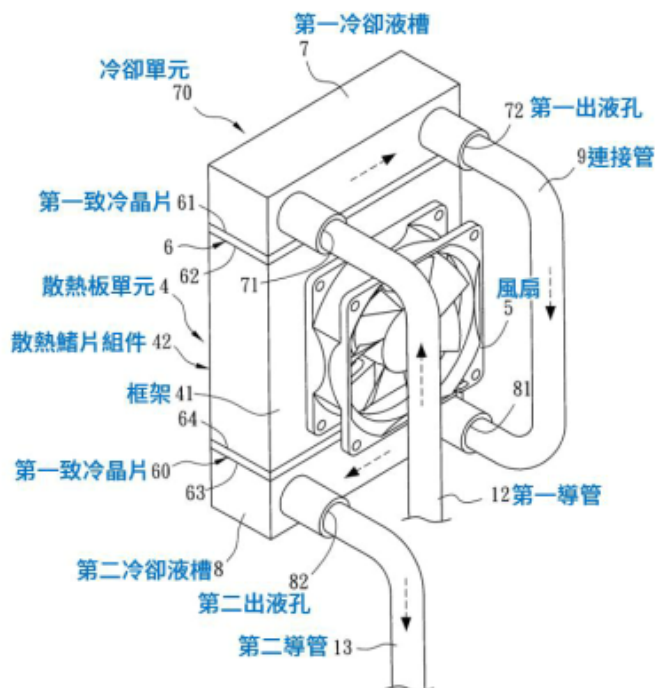
置」發明專利案(原處分卷(-)第197至240頁)，其主要圖式如下：

第4(a)圖係樹脂基材凹部之放大斜視圖



5.證據5為2009年5月16日公開之我國第200922449號「液冷式輔助散熱裝置」發明專利案(原處分卷(-)第187至196頁)，其主要圖式如下：

圖3係液冷式輔助散熱裝置的較佳實施例立體圖



6.上開舉發證據之公開日均早於系爭專利申請日(2017年3月24日)，可為系爭專利之先前技術，而為適格之舉發證據。

(四)證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1至4、6至10不具進步性

01 1.系爭專利請求項1部分：

- 02 (1)依證據1圖1、2及說明書第6、7頁之內容（原處分卷(一)第70
03 至71頁、第61至62頁），揭露一種測試半導體封裝堆疊晶片
04 之測試系統，該測試系統包括一測試機構(43)，而該測試機
05 構(43)包括有一組框架(431)、彈性構件(432)及探針測試裝
06 置(433)，其中證據1之測試系統、測試機構(43)係設有框架
07 (431)，以及探針測試裝置(433)，即分別對應於系爭專利請
08 求項1「一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構、承載器係設
09 有至少一承載件及測試單元」之技術特徵。再觀諸證據1圖2
10 及說明書第7頁第1段之內容（原處分卷(一)第61、70頁），進
11 一步揭露探針測試裝置(433)係裝配於框架(431)，並具有一
12 承載面(4331)及一探針介面板(4332)，並向測試座(411)方
13 向延伸出複數個測試探針(4333)，該些測試探針(4333)一端
14 則是與檢測晶片(5)電性導接，而測試探針(4333)另一端則
15 能夠用於抵觸該測試座(411)上的待測晶片(61)上的微小電
16 極接點，即對應於系爭專利請求項1「測試單元：係裝配於
17 該承載器之該承載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測
18 試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第
19 一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連
20 接一第二電子元件」之技術特徵；證據1之檢測晶片(5)、待
21 測晶片(61)則分別對應系爭專利請求項1之第一、第二電子
22 元件。是證據1與系爭專利請求項1相較，其間差異即在於證
23 據1未揭露系爭專利請求項1「溫控單元：係裝配於該承載器
24 之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該
25 第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該
26 第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電
27 子元件保持預設測試溫度」之技術特徵。
- 28 (2)關於前述之差異技術特徵，由證據2圖1、2及說明書第【000
29 5】、【0026】至【0032】段之內容（原處分卷(一)第34、3
30 5、40、43頁），已揭露一種堆疊式封裝(POP)熱力裝置之設
31 備，該設備具有熱控制單元(110)門鎖至測試插槽120，並具

有熱裝置柱塞(105)與熱中介片(115)，堆疊式封裝IC的頂端(130)由熱裝置柱塞(150)來進行熱控制，而熱裝置柱塞(150)會一起控制頂端(130)與熱中介片(115)，該熱中介片(115)會經由接觸來控制邏輯裝置(135)；另證據2說明書第【0019】段之內容（原處分卷(一)第41至42頁），亦揭露該設備會在熱測試期間同步接觸一頂端IC（通常為一記憶體）以及一底部IC（通常為邏輯裝置），以維持兩個IC的溫度。是以，前述證據2所揭露之內容，即對應於前述證據1與系爭專利請求項1之差異技術特徵，其中證據2之熱裝置柱塞(105)、熱中介片(115)即分別對應於系爭專利請求項1之第一溫控器、第二溫控器。

(3)系爭專利請求項1之全部技術特徵已為證據1及證據2所揭露，業如前述；而證據1、2之技術均屬堆疊式封裝晶片之測試技術領域，且證據1、2之技術內容均利用測試探針來使上、下兩側之晶片形成垂直排列結構，可有效縮短訊號傳輸距離而避免雜訊，具功能或作用之共通性。又證據2說明書第【0009】、【0010】、【0021】段之內容（原處分卷(一)第41、43頁），已教示在封裝後測試時需上下兩個晶片具有正確的溫度，則所屬技術領域中具有通常知識者，基於證據1之半導體封裝堆疊晶片之測試系統，考量如何解決或能提供該測試系統具有溫度控制之功能時，當有合理動機將證據2之熱控制單元、熱裝置柱塞及熱中介片等所構成之溫度控制技術手段組合於證據1之測試系統，進而輕易完成系爭專利請求項1之發明。故證據1及證據2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(4)至原告雖主張：(1)系爭專利請求項1之第一、第二溫控器各具調控溫度的能力，亦即第二溫控器自身即具調控溫度的能力，而證據2具調控溫度能力者僅「熱裝置柱塞」一個而已，兩者自有差異；(2)系爭專利說明書實施例記載之冷卻器僅在於提高壓測機構整體的溫度響應速度，且未記載於申請專利範圍，第一、第二溫控器亦非必須配合冷卻器才能使

01 用，惟前案判決及訴願決定卻將第二溫控器解釋為不具備獨
02 立加熱或致冷之溫度控制能力，已不當將說明書內容讀入申
03 請專利範圍等語。惟查：

04 ①依系爭專利請求項1之申請專利範圍，僅界定「第二溫控
05 器」之功能為「使該第二電子元件保持預設測試溫度」（原
06 處分卷(三)第63頁），且系爭專利請求項8（請求項1之附屬
07 項）始界定「該第二溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流
08 體之本體」之附屬技術特徵（原處分卷(三)第63頁反面），自
09 不能將系爭專利請求項1之第二溫控器當然解釋為與系爭專
10 利請求項8相同，或逕自將說明書之記載（該第二溫控器為
11 致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體）逕自讀入於系爭專
12 利請求項1，是只要能使對象物（第二電子元件）保持於預
13 設測試溫度之溫控器即屬之，故原告上開主張尚非可採。

14 ②依前案判決第43至46頁之內容（本院卷第259至265頁），可
15 知其係認定系爭專利請求項1因未明確說明「溫控器」之定
16 義及限制於何種類之溫度控制器，復以系爭專利說明書第
17 【0012】段載明溫控單元之第一、第二溫控器(36、38)需藉
18 由同一冷卻器(37)方能使第一、第二電子元件(41、42)保持
19 預設測試溫度，並未揭露第一、第二溫控器如何具有主動或
20 獨立調整控制溫度高低的能力，乃解釋系爭專利之「溫控
21 器」係「只要能使各自對象物（第一、二電子元件）保持於
22 預設測試溫度之溫控器即屬之」，而證據2之熱中介片(115)
23 既可使邏輯裝置（對應於系爭專利之第二電子元件）保持於
24 預設測試溫度（參見證據2第【0019】、【0031】段，原處
25 分卷(一)第40至42頁），則證據2之熱中介片(115)自當等同於
26 系爭專利請求項1之第二溫控器。是前案判決並未將系爭專
27 利請求項1之第二溫控器解釋為需包含致冷器在內而不具備
28 獨立加熱或致冷之溫度控制能力，原告就此顯有誤會。

29 2.就系爭專利請求項2至4、6至9部分：

30 (1)系爭專利請求項2係請求項1之附屬項，並界定「該承載器係
31 設有作至少一方向位移之移動臂，該移動臂係裝配該承載

件」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又觀諸證據1圖1及說明書第7頁第2段記載「……該測試臂42係可透過螺桿、皮帶輪組的傳動，讓測試臂42限於測試座411之上方位位置作垂直升降的作動，該下壓時可推動就位之測試機構43……而令測試探針4333下沉至預定位置；測試臂42的下方部位也具備有吸附待測物的功能…」之內容（原處分卷(一)第62、70頁），可見證據1之測試臂(42)即垂直上下移動並與測試機構(43)（測試機構(43)及框架(431)對應系爭專利之承載器及承載件）相配合，即對應於前述附屬技術特徵，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

- (2)系爭專利請求項3係請求項1之附屬項，並界定「該承載器係於該承載件上設有至少一導溫座，該測試單元之該第一測試器係承置至少一接觸該導溫座之該第一電子元件，該溫控單元係於該導溫座裝配該第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又觀諸證據2圖2及說明書【0031】段記載頂端IC(130)（對應系爭專利之第一電子元件）係由熱裝置柱塞(105)（對應系爭專利之第一溫控器）進行熱控制（原處分卷(一)第34、40頁），證據2雖未揭露熱裝置柱塞(105)係裝配於「導溫座」上，惟證據2第【0022】、【0024】段記載熱中介片(10)包含有熱導體(20)，且熱導體(20)接觸堆疊式封裝IC的底部（原處分卷(一)第41頁），第【0030】段記載該熱中介片115係由一或更多個導熱材料及一或更多個電隔離材料所構成（原處分卷(一)第40頁），而由前述證據2揭露熱中介片（對應系爭專利之第二溫控器）另藉由熱導體與電子元件相接觸，或熱中介片係由多個導熱材料所構成等相關內容，發明所屬技術領域中具通常知識者當能輕易思及熱裝置柱塞(105)亦能設有熱導體（對應於系爭專利之「導溫座」）來傳導溫度，其僅為熱導

01 體之應用對象由熱中介片改為熱裝置柱塞之簡單變更，故證
02 據1、2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

03 (3)系爭專利請求項4係請求項3之附屬項，並界定「該承載器之
04 該導溫座係設有至少一接合部件，該接合部件係接觸該第一
05 電子元件」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭
06 專利請求項3不具進步性，已如前述。又前述附屬技術特徵
07 之接合部件，係指「導溫座」上用來接觸第一電子元件之部
08 分，而如前述，證據2揭露熱裝置柱塞(105)係與頂端IC(13
09 0)(對應系爭專利之第一電子元件)相接觸，所屬技術領域
10 中具有通常知識者能輕易思及將熱導體(對應系爭專利之導
11 溫座)設於熱裝置柱塞(105)上，而其既採用相互接觸以進
12 行熱傳導，必然有與頂端IC(130)相接觸之部分而等同於前
13 述附屬技術特徵之接合部件，故證據1、2之組合足以證明系
14 爭專利請求項4不具進步性。

15 (4)系爭專利請求項6係請求項3之附屬項，並界定「該測試單元
16 之該第一測試器係設置於該承載器之該承載件上且位於該導
17 溫座下方，該第一測試器係設有具第一傳輸件之第一測試
18 座，該第一測試座之該第一傳輸件電性連接該第一電子元件
19 之第一電性接點」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證
20 明系爭專利請求項3不具進步性，已如前述。而觀諸證據1說
21 明書第7頁第1段記載「…探針測試裝置433之內部係具有一
22 承載面4331及一探針介面板4332，該承載面4331係用以容置
23 該檢測晶片5，而該承載面4331所容置之檢測晶片5能夠電性
24 導接並向該測試座411方向延伸出複數個測試探針4333，因
25 此該測試探針4333一端則是與檢測晶片5電性導接」之內容
26 (原處分卷(一)第70頁)，可知證據1之探針測試裝置(433)、
27 測試探針(4333)係分別對應於系爭專利之第一測試器、第一
28 傳輸件，而測試探針(4333)既與測試晶片(5)電性導接，必
29 然是連接於測試晶片(5)之接點，即對應於前述附屬技術特
30 徵，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步
31 性。

01 (5)系爭專利請求項7係請求項1之附屬項，並界定「該承載器之
02 該承載件係設有至少一對該第二電子元件執行預設作業之作
03 業治具」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專
04 利請求項1不具進步性，已如前述。又證據1圖2所示之探針
05 測試裝置(433)之下端面部係延伸出測試探針(4333)，而證
06 據1說明書第7頁第1段並記載「…測試探針4333另一端則能
07 夠用於抵觸該測試座411上的待測晶片61上的微小電極接
08 點」(原處分卷(一)第61、70頁)，可見證據1之探針測試裝
09 置(433)設有對於待測晶片(61)執行測試作業之相配合部
10 分；另證據2圖2亦顯示熱中介片(115)之下端部連接於底部I
11 C(135)以執行預設作業(原處分卷(一)第34頁)，即對應前述
12 附屬技術特徵，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項
13 7不具進步性。

14 (6)系爭專利請求項8係請求項1之附屬項，並界定「該溫控單元
15 之該第一溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體，
16 該第二溫控器為致冷晶片、加熱件或具預溫流體之本體」之
17 附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1
18 不具進步性，且證據2揭露之熱裝置柱塞(105)、熱中介片(1
19 15)分別對應於系爭專利之第一、第二溫控器，均如前述；
20 又證據2說明書第【0026】段另記載熱裝置柱塞(105)係被連
21 結至一熱控制單元(TCU)(110)(原處分卷(一)第40頁)，意即
22 證據2係以熱控制單元(110)使熱裝置柱塞(105)與熱中介片
23 (115)維持一定溫度，而所屬技術領域中具有通常知識者由
24 「熱控制單元(TCU)」一詞，即知其係指具有加熱器或熱交
25 換器等而能調節溫度之裝置，是雖證據2並未明確揭露致冷
26 晶片、加熱件等技術特徵，然致冷晶片、加熱件等僅係一般
27 常用於控制溫度之習知器件，況且所屬技術領域中具有通常
28 知識者基於前述證據2所揭露之內容，當可依其對於溫度控
29 制之實際需求，將熱裝置柱塞、熱中介片置換為致冷晶片、
30 加熱件等而輕易完成系爭專利請求項8之發明，屬於證據2技

術內容之簡單變更，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

(7)系爭專利請求項9係請求項1之附屬項，並界定「該溫控單元係於該承載件裝配有至少一冷卻器」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又證據1、2雖未揭示冷卻器，惟冷卻器僅係一般常用於控制溫度之習知器件，而證據2既已揭露「熱控制單元(TCU)」，則所屬技術領域中具通常知識者當可依其溫度調節或控制上之需求而配置冷卻器，況且系爭專利說明書自承之先前技術（參系爭專利第3圖），即已說明習知之壓測機構中設有與加熱件(23)相互搭配之冷卻器(22)，顯見冷卻器之配置僅屬通常知識者依申請時之通常知識對於證據1、2技術內容之簡單變更，故證據1、2之組合仍足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

3.系爭專利請求項10部分：

(1)依證據1圖3A及說明書第8頁第6至7行記載「本發明所述之半導體自動化測試機台如圖3A所示，更包括有用以提供擺放具有複數待測晶片61之載盤11的進料區1…」之內容（原處分卷(一)第60、69頁），即對應揭露系爭專利請求項10「機台；供料裝置：係裝配於該機台，並設有至少一容納待測之第二電子元件的供料承置器」之技術特徵，其中證據1之進料區(1)、載盤(11)與待測晶片(61)分別對應於系爭專利請求項10之供料裝置、供料承置器與待測之第二電子元件。又證據1第8頁第7至8行記載「用以提供擺放具有複數完測晶片62之複數載盤21的出料區2」之內容（原處分卷(一)第69頁），即對應揭露系爭專利請求項10「收料裝置：係裝配於該機台，並設有至少一容納已測之該第二電子元件的收料承置器」之技術特徵；證據1第8頁第8至10行記載「一組用以搬移待測晶片61於進料區1之載盤11、出料區2之載盤21及測試區4間之受X-Y機構控制的拾取臂3」之內容（原處分卷(一)第69頁），即對應揭露系爭專利請求項10「輸送裝置：係裝配於

該機台，並設有至少一移載該第二電子元件之移料器」之技術特徵。再證據1圖3C中所示之測試機構(43)，對照圖1、2顯示測試機構(43)具有測試座(411)承置待測晶片(61)（參證據1說明書第7頁第1段，原處分卷(一)第58頁、第61至62頁、第70頁），即對應揭露系爭專利請求項10「測試裝置：係裝配於該機台，並設有至少一承置該第二電子元件之第二測試器」之技術特徵。另證據1說明書第8頁末段至第9頁第3段揭示晶片搬運與測試之自動化作業流程（原處分卷(一)第68至69頁），即隱含其具備有控制並整合各裝置作動之中央控制裝置而對應揭露系爭專利請求項10「中央控制裝置：係用以控制及整合各裝置作動，而執行自動化作業」之技術特徵。

(2)承上所述，系爭專利請求項10之上開技術特徵既均為證據1所揭露，且其記載之「壓測機構」技術特徵（「至少一依申請專利範圍第1項所述之堆疊式封裝電子元件之壓測機構，以對該第二電子元件執行預設測試作業」），係引用請求項1所載之技術特徵，而關於證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性之理由，及證據1、2之結合動機俱如前所述，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項10不具進步性。

(五)證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性

1.系爭專利請求項5係依附於請求項3，並界定「該承載器係於該承載件與該導溫座之間設有至少一隔離件」之附屬技術特徵。證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性，已如前述。又參酌系爭專利說明書第5頁第23至25行記載「……為避免承載件32與導溫座33相互影響傳導之溫度，係於承載件32與導溫座33之間設有至少一隔離件34……」之內容（原處分卷(一)第94頁），可知前述附屬技術特徵所界定之隔離件，係在隔離或避免承載件與導溫座間之熱傳導；而證據1、2雖未揭示隔離件，但證據2說明書第【0021】至【0025】段已教示將利用熱導體及絕緣體之形狀（熱中介片(1

01 0)) 來控制傳導至晶片的熱流路徑(原處分卷(一)第41頁),
02 且證據3說明書第【0023】段亦揭示「……隔離板用來使歧
03 管及通道板彼此熱絕緣……隔離板用來防止熱量在歧管之冷
04 或熱流體與冷卻通道之間的方向上之傳遞。此使得熱量傳遞
05 主要是與通道板之通道中的流體進行。」(原處分卷(一)第23
06 頁),即證據3已揭露前述附屬技術特徵。

07 2.證據1、2間之組合動機詳如前述。而證據3之技術內容亦關
08 於半導體測試之設備或機台,與證據1、2屬相同或相關連之
09 技術領域;證據2及證據3並均使用「熱控制單元(TCU)」或
10 「熱控制系統/溫度控制致動器(107)」來控制測試時之溫
11 度,具有功能或作用之共通性,且證據2係以測試時上下兩
12 個晶片具有正確的溫度為目的,並教示將利用熱導體及絕緣
13 體之形狀來控制傳導至晶片的熱流路徑,證據3亦教示可利
14 用隔離板來防止熱量在特定方向上的傳遞,則所屬技術領域
15 中具有通常知識者,基於證據1、2之封裝堆疊晶片測試系
16 統,考量如何設計特定或較佳的熱流路徑時,當有合理動機
17 組合證據3之隔離板於證據1、2之測試系統中,避免熱量在
18 非熱流路徑上傳遞,進而輕易完成系爭專利請求項5之發
19 明,故證據1、2及3之組合足以證明系爭專利請求項5不具進
20 步性。

21 (六)至證據1、2、4之組合及證據1、2、5之組合是否足以證明系
22 爭專利請求項1至4、6至10不具進步性,以及證據1、2、3、
23 4之組合及證據1、2、3、5之組合是否足以證明系爭專利請
24 求項5不具進步性部分,其中證據4之技術內容係關於以化學
25 反應或DNA反應之反應晶片及反應方法,與證據1至3係關於
26 半導體元件之測試設備,其技術領域差異甚大,且就所欲解
27 決之問題及功能、作用亦無共通性,是以所屬技術領域中具
28 有通常知識者應無將證據4與證據1、2或證據1、2、3相互結
29 合之動機。另證據5之技術內容係關於液冷式輔助散熱裝
30 置,並以致冷晶片進行溫度調控以迅速輔助散熱,與證據1
31 係提供自動化的堆疊晶片測試機台,或證據2係解決上下兩

01 個晶片溫度不均，以及證據3係增進溫度控制致動器之流體
02 流動，其目的、功能或作用並不相同，亦難謂有將證據5與
03 證據1、2或證據1、2、3相互結合之動機。惟證據1、2之組
04 合既已足以證明系爭專利請求項1至4、6至10不具進步性，
05 證據1、2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步
06 性，則縱令證據4、5分別與證據1、2或證據1、2、3並無組
07 合動機，而無從將之組合後據以認定系爭專利請求項1至4、
08 6至10或系爭專利請求項5不具進步性，仍無礙於前述有關係
09 爭專利請求項1至4、6至10及系爭專利請求項5不具進步性之
10 認定。

11 七、綜上所述，證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1至4、
12 6至10不具進步性，證據1、2、3之組合亦足以證明系爭專利
13 請求項5不具進步性。從而，原處分所為「請求項1至10舉發
14 成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，
15 亦無不合。原告訴請撤銷原處分關於「請求項1至10舉發成
16 立，應予撤銷」部分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

17 八、本件判決基礎已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法及
18 訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論
19 述之必要，併此敘明。

20 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
21 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

22 中 華 民 國 111 年 7 月 20 日

23 智慧財產第三庭

24 審判長法 官 彭洪英

25 法 官 王碧瑩

26 法 官 林怡伸

27 以上正本係照原本作成。

28 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
29 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
30 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
31 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴

時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 111 年 7 月 27 日
書記官 鄭楚君